



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100226000
2010 年 9 月 28 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR(パワーマネジメント) TPS73xxx製品 チップ一部改定のご案内

(初版 PCN20100226000 2010 年 3 月 16 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	PWR(パワーマネジメント) TPS73xxx 製品 チップ一部改定 現行 : チップレビジョン “A” 変更後: チップレビジョン “B”			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) TPS73xxx 製品について、製品性能/堅牢性向上の為に、対象製品のチップを一部改定し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
チップ一部改定	レビジョン “A”	レビジョン “B”

理由：製品性能/堅牢性向上の為

詳細：

チップ改定内容：

1. 高温時ラッチアップ防止のため、銅配線層スペースを変更します。
2. 出力電圧オプション再構成のため、メタル変更を実施します。

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00027DBVR	TPS73133DBVTG4	TPS73218DCQR	TPS73250DCQG4	TPS73619DRBR
HPA00028DBVR	TPS73150DBVR	TPS73218DCQRG4	TPS73250DCQR	TPS73619DRBRG4
HPA00246DRBR	TPS73150DBVRG4	TPS73218DRV	TPS73250DCQRG4	TPS73619DRBT
HPA00357DBVR	TPS73150DBVT	TPS73218DRVT	TPS73601DBVR	TPS73619DRBTG4
HPA00408DBVR	TPS73150DBVTG4	TPS73219DBVR	TPS73601DBVRG4	TPS73625DBVR
HPA00642DRBR	TPS73201DBVR	TPS73219DBVRG4	TPS73601DBVT	TPS73625DBVRG4
TPS73101DBVR	TPS73201DBVRG4	TPS73219DBVT	TPS73601DBVTG4	TPS73625DBVT
TPS73101DBVRG4	TPS73201DBVT	TPS73219DBVTG4	TPS73601DCQ	TPS73625DBVTG4
TPS73101DBVT	TPS73201DBVTG4	TPS73225DBVR	TPS73601DCQG4	TPS73625DCQ
TPS73101DBVTG4	TPS73201DCQ	TPS73225DBVRG4	TPS73601DCQR	TPS73625DCQG4
TPS73115DBVR	TPS73201DCQG4	TPS73225DBVT	TPS73601DCQRG4	TPS73625DCQR
TPS73115DBVRG4	TPS73201DCQR	TPS73225DBVTG4	TPS73601DRBR	TPS73625DCQRG4
TPS73115DBVT	TPS73201DCQRG4	TPS73225DCQ	TPS73601DRBRG4	TPS73630DBVR
TPS73115DBVTG4	TPS73201DRBR	TPS73225DCQG4	TPS73601DRBT	TPS73630DBVRG4
TPS73118DBVR	TPS73201DRBRG4	TPS73225DCQR	TPS73601DRBTG4	TPS73630DBVT
TPS73118DBVRG4	TPS73201DRBT	TPS73225DCQRG4	TPS73615DBVR	TPS73630DBVTG4
TPS73118DBVT	TPS73201DRBTG4	TPS73230DBVR	TPS73615DBVRG4	TPS73630DCQ
TPS73118DBVTG4	TPS73201DRV	TPS73230DBVRG4	TPS73615DBVT	TPS73630DCQG4
TPS73125DBVR	TPS73201DRVT	TPS73230DBVT	TPS73615DBVTG4	TPS73630DCQR
TPS73125DBVRG4	TPS73215DBVR	TPS73230DBVTG4	TPS73615DCQ	TPS73630DCQRG4
TPS73125DBVT	TPS73215DBVRG4	TPS73230DCQ	TPS73615DCQG4	TPS73632DBVR
TPS73125DBVTG4	TPS73215DBVT	TPS73230DCQG4	TPS73615DCQR	TPS73632DBVRG4
TPS73130DBVR	TPS73215DBVTG4	TPS73230DCQR	TPS73615DCQRG4	TPS73632DBVT
TPS73130DBVRG4	TPS73215DCQ	TPS73230DCQRG4	TPS73615DRBR	TPS73632DBVTG4
TPS73130DBVT	TPS73215DCQG4	TPS73233DBVR	TPS73615DRBRG4	TPS73633DBVR
TPS73130DBVTG4	TPS73215DCQR	TPS73233DBVRG4	TPS73615DRBT	TPS73633DBVRG4
TPS73131DBVR	TPS73215DCQRG4	TPS73233DBVT	TPS73615DRBTG4	TPS73633DBVT
TPS73131DBVRG4	TPS73216DBVR	TPS73233DBVTG4	TPS73616DBVR	TPS73633DBVTG4
TPS73131DBVT	TPS73216DBVRG4	TPS73233DCQ	TPS73616DBVT	TPS73633DCQ
TPS73131DBVTG4	TPS73216DBVT	TPS73233DCQG4	TPS73618DBVR	TPS73633DCQG4
TPS73132DBVR	TPS73216DBVTG4	TPS73233DCQR	TPS73618DBVRG4	TPS73633DCQR
TPS73132DBVRG4	TPS73218DBVR	TPS73233DCQRG4	TPS73618DBVT	TPS73633DCQRG4
TPS73132DBVT	TPS73218DBVRG4	TPS73250DBVR	TPS73618DBVTG4	TPS73633DRBR
TPS73132DBVTG4	TPS73218DBVT	TPS73250DBVRG4	TPS73618DCQ	TPS73633DRBRG4
TPS73133DBVR	TPS73218DBVTG4	TPS73250DBVT	TPS73618DCQG4	TPS73633DRBT
TPS73133DBVRG4	TPS73218DCQ	TPS73250DBVTG4	TPS73618DCQR	TPS73633DRBTG4
TPS73133DBVT	TPS73218DCQG4	TPS73250DCQ	TPS73618DCQRG4	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載のレビジョンコード(ラベル箇所:2P)が下記の様になります。

	チップレビジョンコード(2P)
現行	A
変更後	B



図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 9 月 20 日	
信頼性試験 — 試料構成詳細					
Qual Device:	TPS73643	Die Size (mm):	0.940 X 1.422		
Wafer Fab:	DFAB	Fab Process:	LBC4x		
Die Protective Coating:	12KAN	-	-		
Assembly Site:	CARSEM M	Package Code/Pins:	DBV/5		
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	31922001		
Bond Wire:	1.3 Mil Dia. Au	Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu		
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-		
信頼性試験結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	12/0	12/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	77/0	-	
**Autoclave	121C, 240 Hrs	77/0	77/0	-	
**T/C	-65C/150C, 1000 Cycle	77/0	77/0	-	
**Thermal Shock	-65C/150C, 200 Cycle	77/0	-	-	
**Steady-state Life Test	155C, 240 Hrs	116/0	-	-	
Latch-up	Per JESD78	12/0	-	-	
ESD HBM	3 unit/level, 1kV, 1.5kV, 2kV	9/0	-	-	
ESD CDM	3 unit/level, 200V, 500V	6/0	-	-	
X-Ray	Top side only	5/0	-	-	
Electrical Characterization	Full temp & voltage range	Approved	-	-	
Manufacturability	per site spec	Approved	-	-	
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-2 /260C					

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年9月20日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Device ID:	Device1	Device2	Device3	
Qual Device:	TPS73133DBV	TPS73643DBV	TPS73201DBV	
Die Size (mm):	1.49 X 0.94	1.49 X 0.94	1.49 X 0.94	
Wafer Fab:	DFAB	DFAB	DFAB	
Fab Process:	LBC4x	LBC4x	LBC4x	
Die Protective Coating:	12KAN	12KAN	12KAN	
Assembly Site:	UTAC-2	CARSEM M	UTAC-2	
Package Code/Pins:	DBV/5	DBV/5	DBV/5	
Mount Compound:	142010008	4205846	142010008	
Mold Compound:	434990	31922001	434990	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia. Au	1.3 Mil Dia. Au	1.3 Mil Dia. Au	
Lead Frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	JEDEC L-2/260C	JEDEC L-2/260C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Device1	Device2	Device3
Manufacturability	per site spec	Approved	-	Approved
**Steady-state Life Test	150C, 300 Hrs	-	77/0	-
Electrical Characterization	Side by Side	-	Approved	-
Note: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-2 /260C				